

반도체공동연구소-엠코테크놀로지코리아(주) 반도체 패키징 현장 견학 프로그램 계획(안)

I 목 적

- 지역 반도체 인재양성과 산학협력 강화를 위해 반도체 패키징 분야의 산업체 실무 현장을 직접 체험할 수 있는 견학 프로그램
- 학생들이 현장 이해도를 높이고 전공 지식을 실무와 연계함으로써 취업 역량을 강화하고 지역 반도체 생태계 활성화에 기여하는 것을 목적으로 함.

I 개 요

- 프로그램명 : 반도체 패키징 현장 견학 프로그램
- 일 시: 2025. 11. 14.(금) 14:00-17:00
- 장 소: 엠코테크놀로지코리아(주) 광주사업장
- 참석대상
 - 전남대학교 공과대학 학부생 40명 (학년무관)
(신소재공학부 14명, 전자컴퓨터공학부 13명, 화학공학부 13명)
- 내 용
 - 기업 및 반도체 패키징 공정 관련 소개
 - 생산현장 견학 및 기타 질의응답

III 일정(안)

시 간	내 용	비 고
14:00 ~ 14:30	▶ 전남대학교 출발 (집결지 : 전남대학교 공대2호관 앞)	대형버스1대임차
14:30 ~ 15:30	▶ 기업 및 패키징 공정 소개	
15:30 ~ 16:30	▶ 생산 현장 견학	
16:00 ~ 16:30	▶ 질의응답	
16:30 ~ 17:00	▶ 전남대학교 복귀	